

CMP用スラリー (CMP Slurry)

EPL2361™

EPL2361 は、メタル微細配線で主に使われる Cu 用の CMP スラリーです。コロイダルシリカがベース砥粒となり、そこに界面活性剤等が添加してあります。台湾のエポック・マテリアル社で製造いたしております。実際のご使用時には、酸化剤(過酸化水素水)を混ぜてご使用いただくタイプです。



This slurry is mainly used for Cu-CMP of metal interconnect.
The surface-active agent is added to the colloidal silica as a base abrasive.
This slurry is manufactured by EPOCH MATERIAL CO., LTD in Taiwan.
It is used by mixing an oxidizer (hydrogen peroxide).

特長 (Benefits)

- 低面圧下でも高研磨レート (High removal rate even under low pressure)
- 安定性が高い (High stability)
- 段差緩和性等に優れる (Excellent planarization efficiency)
- 廃液処理が容易 (Easy disposal)

また、CMP中に研磨パッド表面に銅の錯体が蓄積される場合がありますので、その際のパッド表面クリーナー「EPL8120™」もご用意いたしております。

When a copper complex is accumulated on the surface of polishing pad during CMP, we offer “EPL8120™” as a pad cleaner.

SSA™ シリーズ (SSA™ Series)

SSA シリーズは特に Cu-CMP において、Ta や TaN 等のバリアメタル向けに開発されたスラリーです。

This slurry is developed for Ta/TaN polishing as a barrier layer at Cu-CMP.

特長 (Benefits)

- 高い性能安定性 (Performance consistency)
 - ⇒ 製品安定性 (Product stability)
 - ⇒ 高速バリア除去 (Rapid barrier removal)
 - ⇒ 良低圧研磨性 (Low stress/Low pressure polishing)
 - ⇒ CDO系 Low-K膜との最適な選択比 (Good selectivity to Low-K, CDO)
- 歩留り改善 (Yield improvement)
 - ⇒ ディフェクトが少ない (Superior defectivity)
 - ⇒ ファングのようなエロージョンが無い (Limited fanging <100Å)
 - ⇒ 膜剥がれが起りにくい (Delamination eliminated)

※ EPL2361™, EPL8120™は EPOCH MATERIAL 社、SSA™は Rohm and Haas Electronic Materials 社の商標です。

